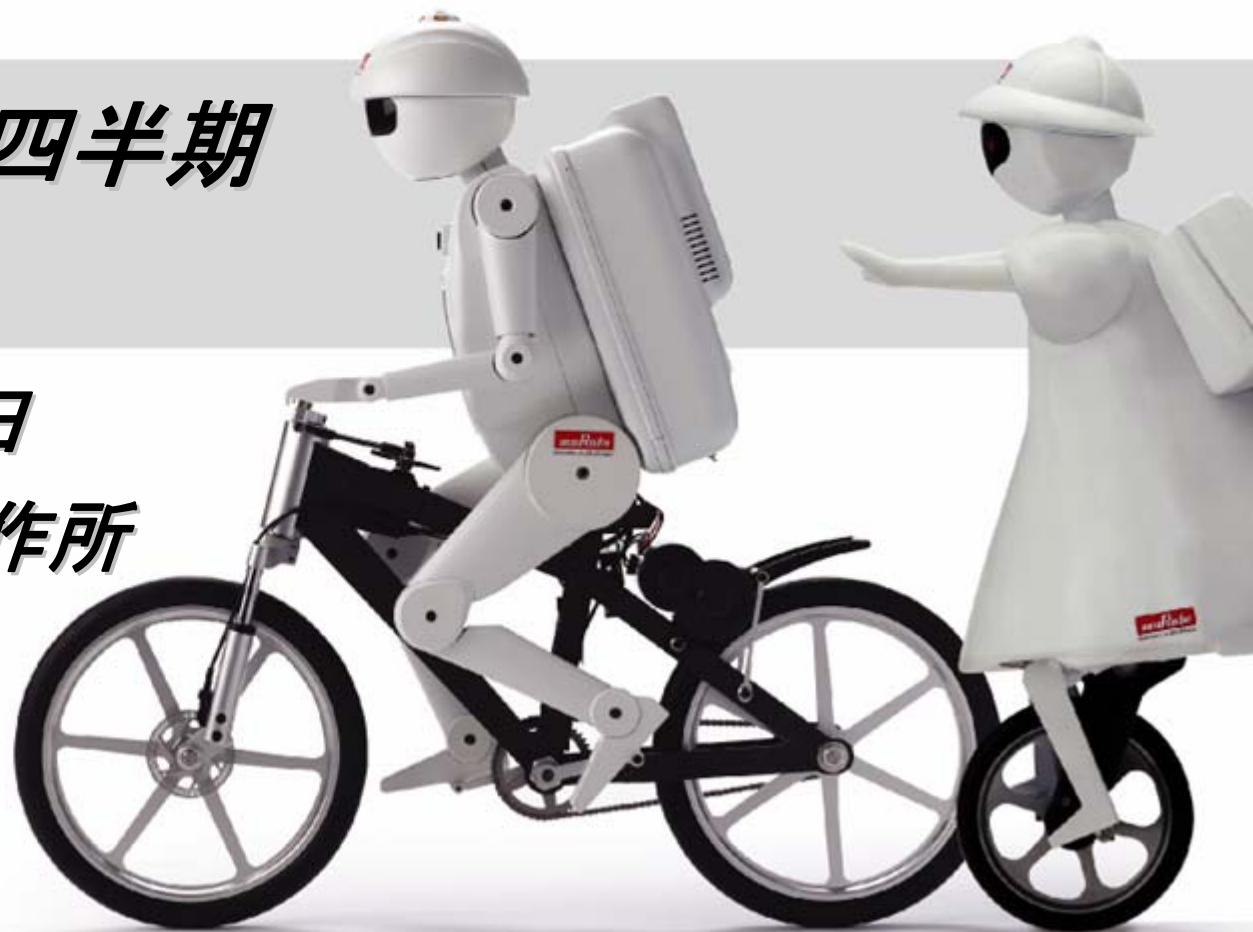


2009年度第1四半期 決算説明会

2009年7月29日

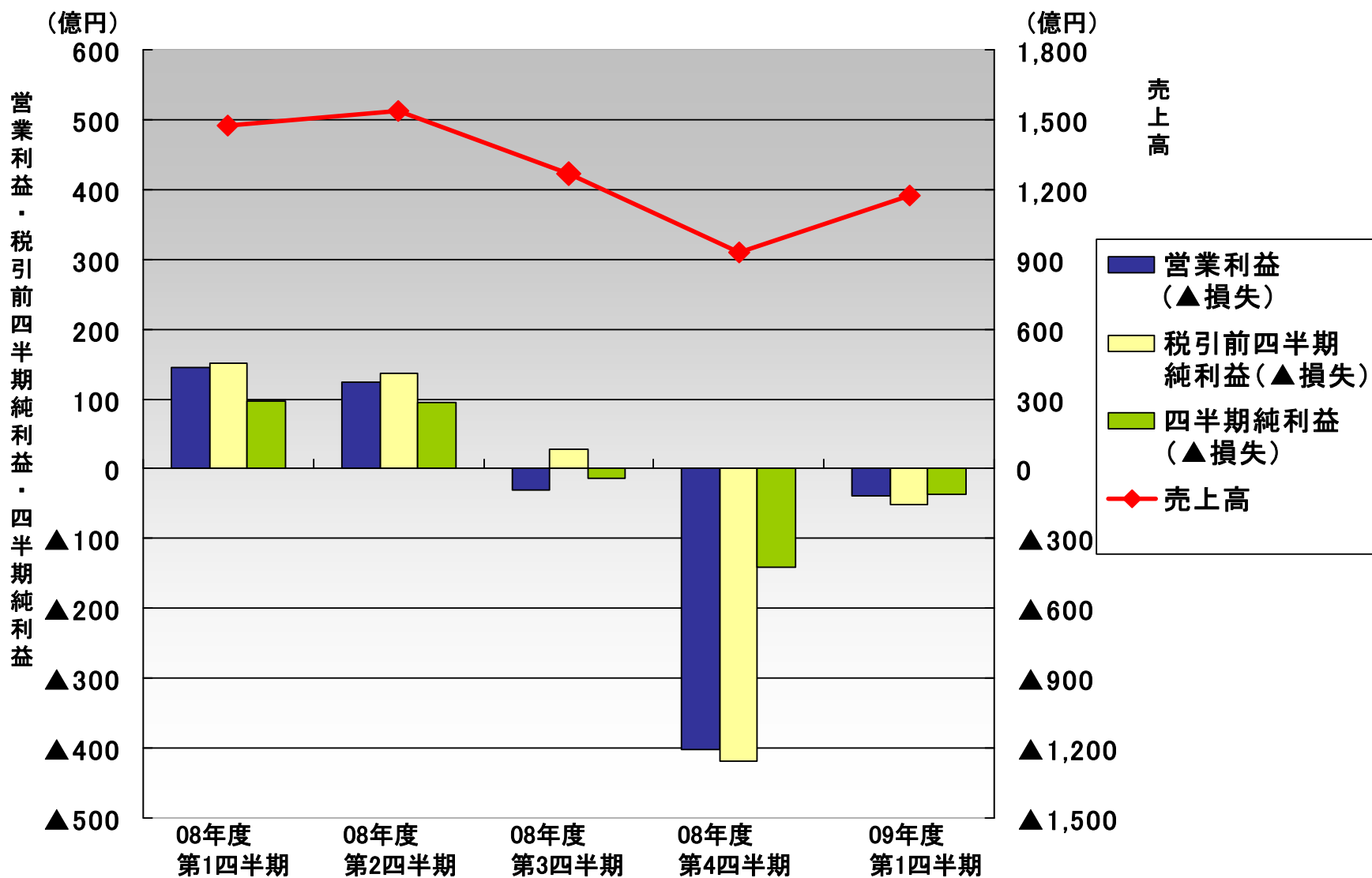
株式会社村田製作所



1. 2009年度 第1四半期業績概要

**2009年4月～2009年6月
第1四半期連結会計期間**

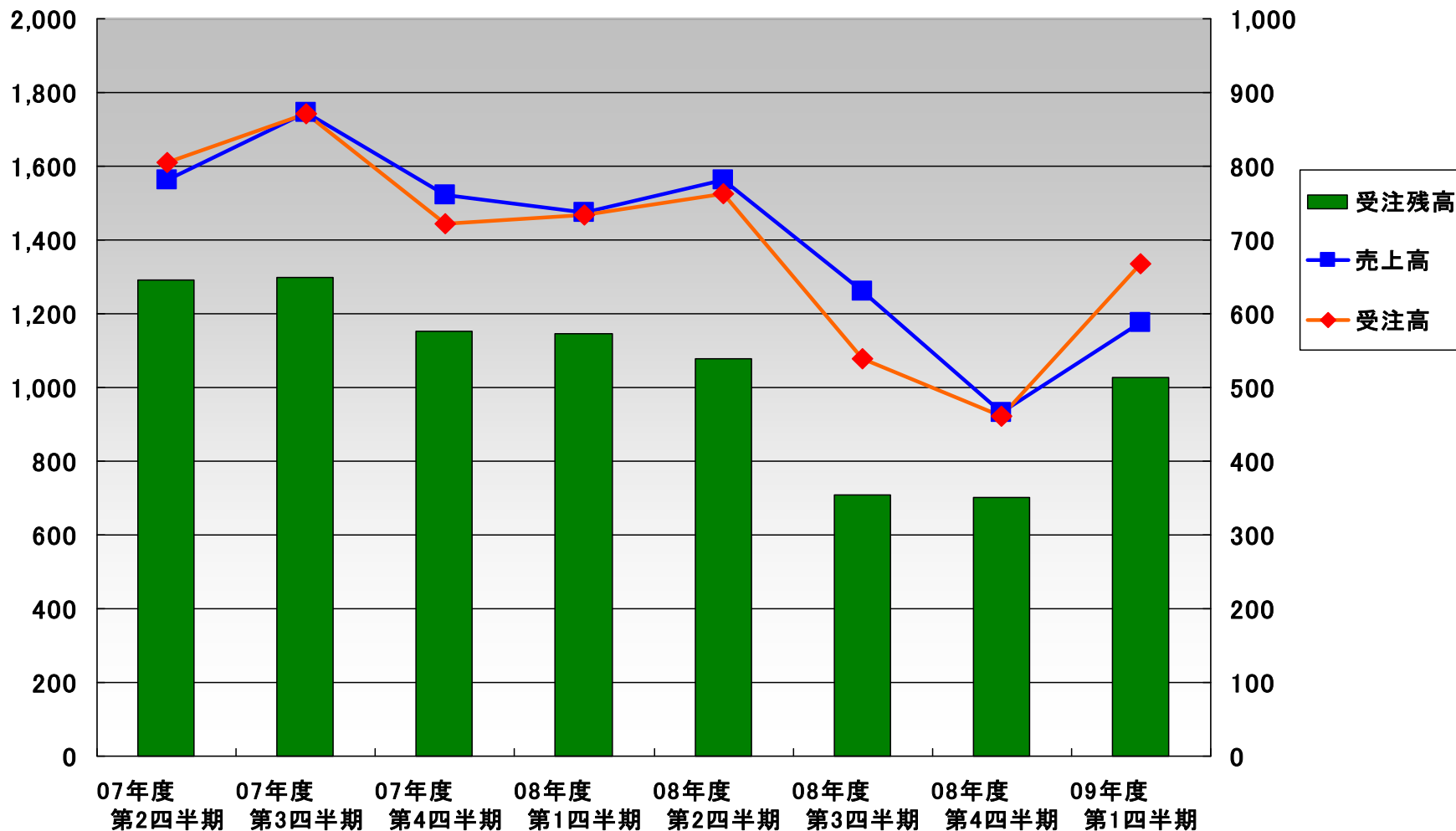
業績概要



四半期の売上・受注・注残推移

売上高・受注高(億円)

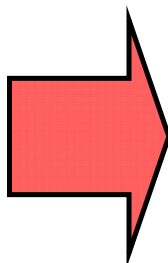
受注残高(億円)



製品別売上分類の変更

<旧分類>

	2009年度 第1四半期
	(億円)
コンデンサ	382
圧電製品	175
高周波デバイス	289
モジュール製品	133
その他製品	192
合計	1,171

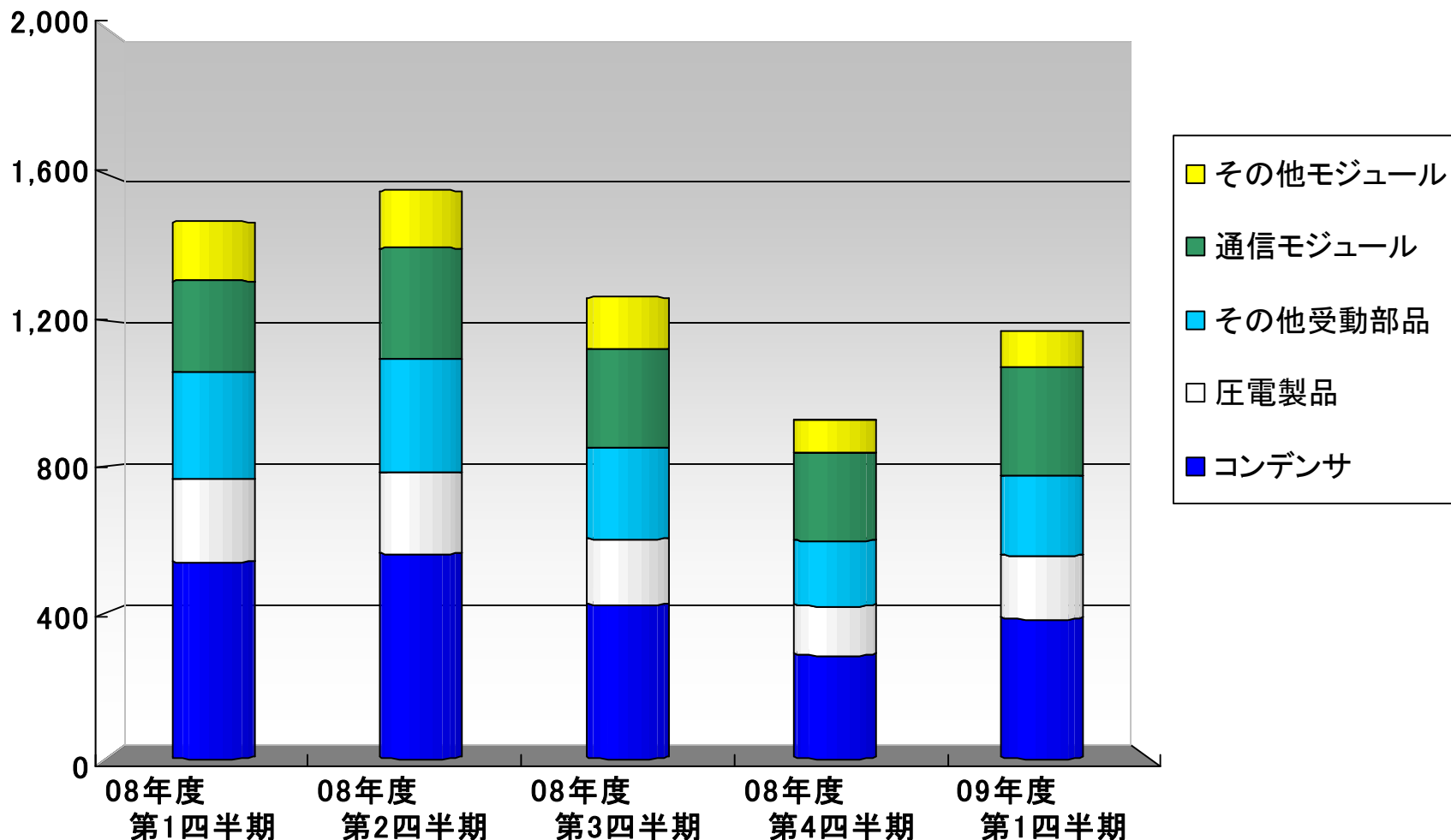


<新分類>

		2009年度 第1四半期
		(億円)
受動部品	コンデンサ	382
	圧電製品	175
	その他受動部品	217
モジュール	通信モジュール	298
	その他モジュール	99
合計		1,171

製品別売上高推移

(億円)



製品別売上高

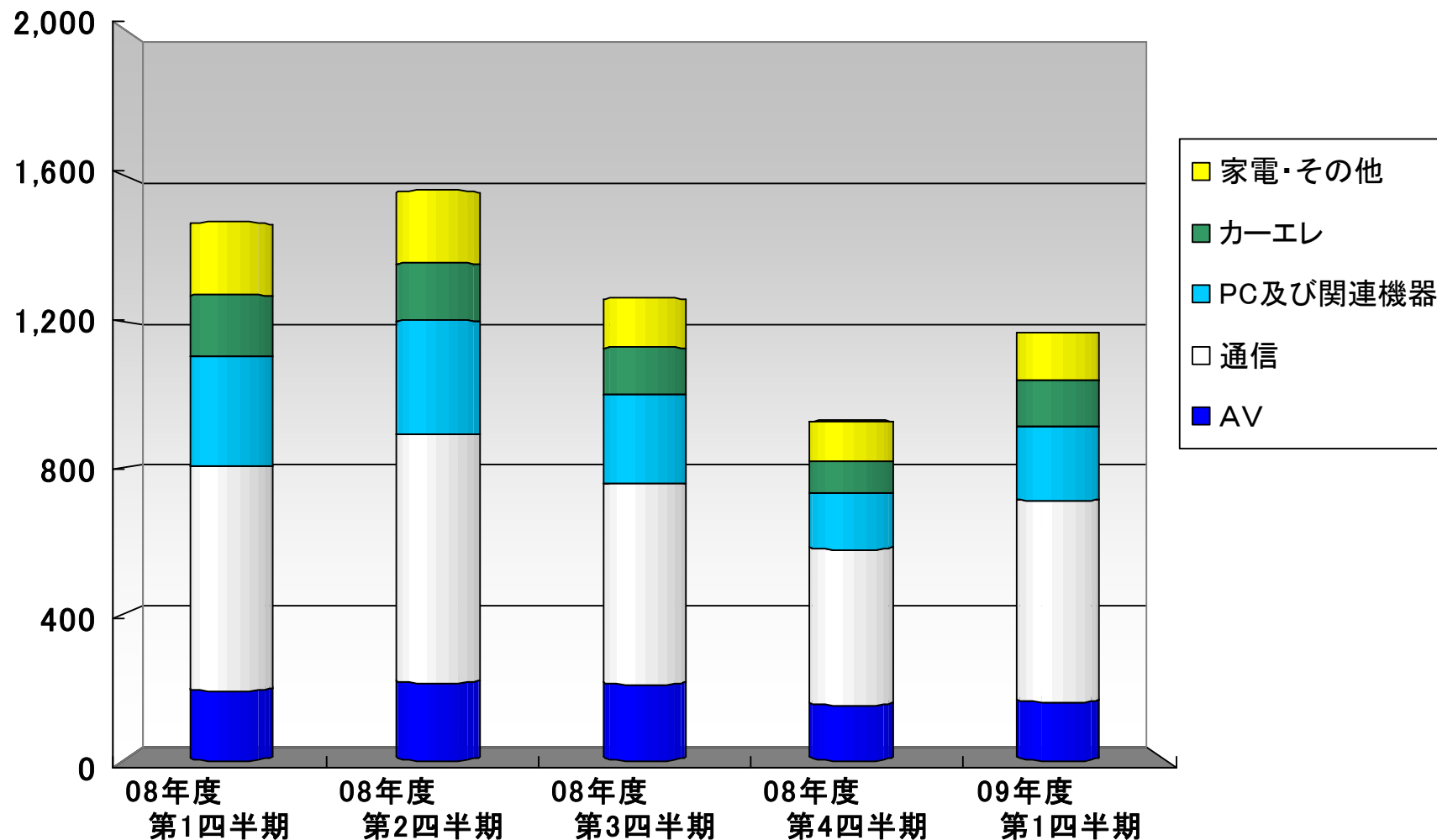
	2008年度 第1四半期		2009年度 第1四半期		増減	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
コンデンサ	539	36.6	382	32.6	▲157	▲29.1
圧電製品	227	15.4	175	15.0	▲51	▲22.6
その他受動部品	292	19.9	217	18.6	▲75	▲25.7
通信モジュール	253	17.2	298	25.4	+44	+17.5
その他モジュール	160	10.9	99	8.4	▲61	▲38.4
製品売上高計	1,471	100.0	1,171	100.0	▲300	▲20.4

製品別売上高

<p>コンデンサ (前年同期比▲29.1%)</p>	<ul style="list-style-type: none">• チップ積層セラミックコンデンサ：すべての用途で大幅に減少 (大容量コンデンサは数量増)• 用途特化型品：PC及び関連機器向けで大きく減少
<p>圧電製品 (前年同期比▲22.6%)</p>	<ul style="list-style-type: none">• 表面波フィルタ、：通信機器向けで減少(数量では増加)• セラミック発振子、セラミックフィルタ：カーエレ向けで大幅に減少• 圧電センサ：HDD及びカーエレ向けで大きく減少
<p>その他受動部品 (前年同期比▲25.7%)</p>	<ul style="list-style-type: none">• EMI除去フィルタ：AV機器、PC及び関連機器向けで大幅に減少• チップコイル：通信機器向けで減少(数量では増加)
<p>通信モジュール (前年同期比+17.5%)</p>	<ul style="list-style-type: none">• 近距離通信モジュール：無線LANモジュールが大幅に伸長• 多層デバイス、回路モジュール：携帯電話用の地上デジタルチューナと通信機器用モジュールが大きく減少
<p>その他モジュール (前年同期比▲38.4%)</p>	<ul style="list-style-type: none">• 電源：AV機器、PC及び関連機器向けで大幅に減少

用途別売上高推移

(億円)



用途別売上高

	2008年度 第1四半期		2009年度 第1四半期		増減	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
AV	188	12.8	160	13.6	▲28	▲15.1
通信	615	41.8	551	47.1	▲64	▲10.4
PC及び関連機器	300	20.4	202	17.3	▲98	▲32.5
カーエレ	168	11.4	126	10.8	▲42	▲25.0
家電・その他	199	13.6	132	11.2	▲68	▲34.0
製品売上高計	1,471	100.0	1,171	100.0	▲300	▲20.4

用途別売上高

AV機器 (前年同期比▲15.1%)	<ul style="list-style-type: none">薄型テレビ向け、DSC向け、ゲーム機向けが大幅に減少携帯型オーディオプレーヤー向けで大幅に増加
通信 (前年同期比▲10.4%)	<ul style="list-style-type: none">第3世代機向けに無線LANモジュールが大幅に増加通信機器全般にチップ積層セラミックコンデンサ、表面波フィルタが大きく減少
PC及び関連機器 (前年同期比▲32.5%)	<ul style="list-style-type: none">すべてのセットで大幅に減少
カーエレ (前年同期比▲25.0%)	<ul style="list-style-type: none">カーオーディオ向け、カーナビ向け、ソナー向け、RKE向けが減少

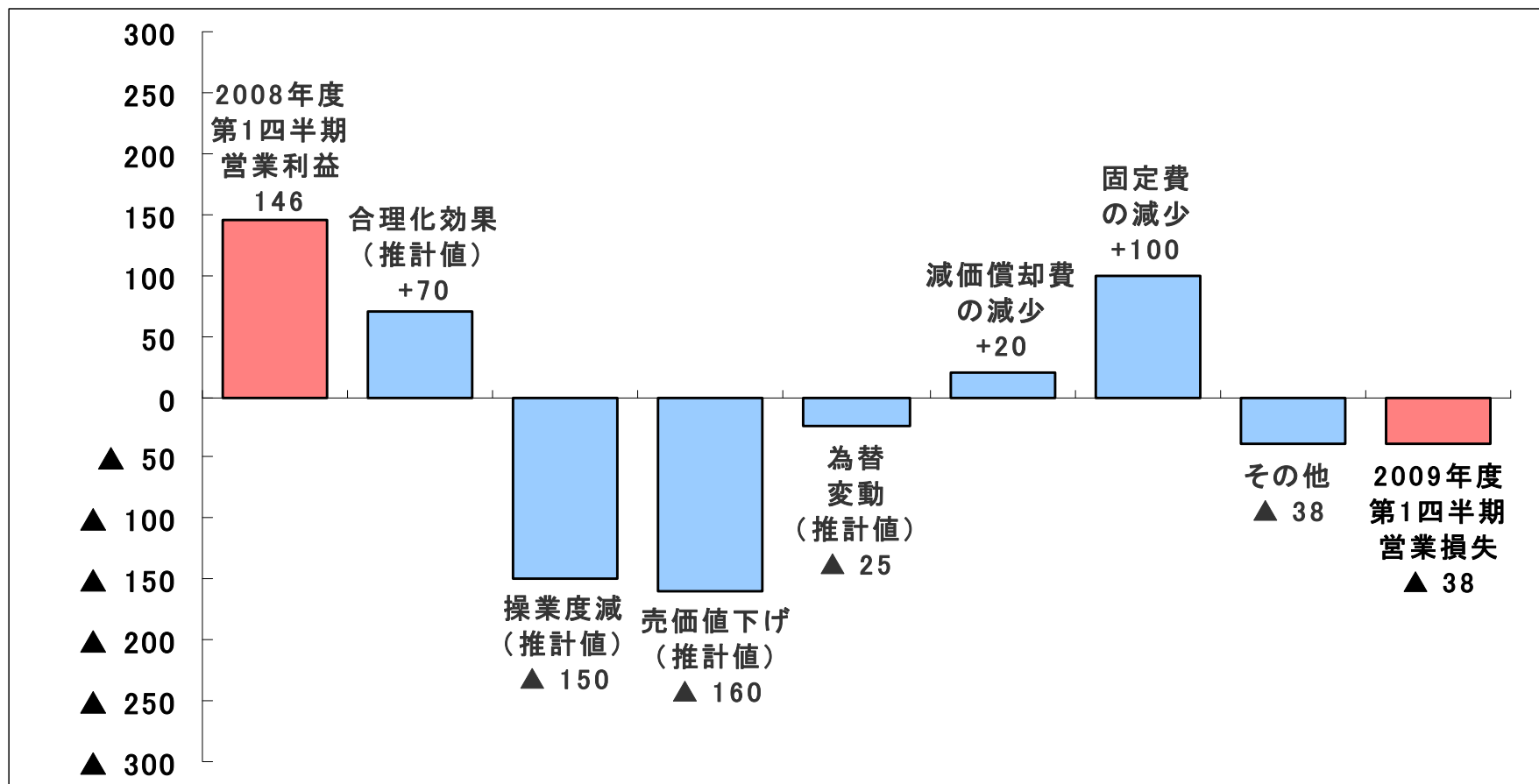
※RKE:リモート・キーレス・エントリー

業績概況(2009年度第1四半期)

	2008年度 第1四半期		2009年度 第1四半期		増減	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
売上高	1,476	100.0	1,175	100.0	▲301	▲20.4
営業利益(▲損失)	146	9.9	▲38	▲3.2	▲183	—
税引前利益(▲損失)	151	10.2	▲51	▲4.3	▲202	—
当期純利益(▲損失)	96	6.5	▲37	▲3.1	▲133	—

2009年度第1四半期 営業利益変動要因

(億円)



2. 2009年度 業績予想

(2009年4月～2010年3月)

製品別受注残高

	2009年 3月末		2009年 6月末		増減	
	金額	月齢	金額	月齢	金額	増減率
	(億円)		(億円)		(億円)	(%)
コンデンサ	90	1.0	164	1.3	+74	+82.1
圧電製品	47	1.0	76	1.3	+29	+62.5
その他受動部品	63	1.1	79	1.1	+17	+26.4
通信モジュール	127	1.6	160	1.6	+32	+25.3
その他モジュール	23	0.7	34	1.0	+12	+51.6
受注残高計	350	1.1	514	1.3	+164	+46.8

製品別売上予想

	2009年度 第1四半期		2009年度 第2四半期 売上高予想 (09Q1比較)
	受注高実績	売上高実績	
	(億円)	(億円)	
コンデンサ	456	382	+20%程度
圧電製品	205	175	+8%程度
その他受動部品	234	217	+10%程度
通信モジュール	330	298	+10%程度
その他モジュール	110	99	+5%程度
合計	1,335	1,171	+12.8%

2009年度の業績予想

	従来予想	今回予想			従来予想
	2009年 上期予想	第1四半期 実績	第2四半期 予想	2009年 上期予想	下期 予想
売上高	(億円) 2,350	(億円) 1,175	(億円) 1,325	(億円) 2,500	(億円) 2,550
営業利益(▲損失)	▲ 80	▲ 38	28	▲ 10	0
税引前利益(▲損失)	▲ 60	▲ 51	51	0	20
当期純利益(▲損失)	▲ 30	▲ 37	37	0	10

業績予想の前提

	2009年度 上期予想	2009年度 下期予想	2009年度 通期予想
減価償却費	330億円	370億円	700億円
研究開発費	215億円	215億円	430億円
設備投資額	120億円	100億円	220億円
為替レート(US\$)	95.0円/US\$ (第2四半期)	95.0円/US\$	

当資料に記載されている、当社又は当社グループに関する見通し、計画、方針、戦略、予定、判断などのうち既に確定した事実でない記載は、将来の業績に関する見通しです。将来の業績の見通しは、現時点で入手可能な情報と合理的と判断する一定の前提に基づき当社グループが予測したものです。実際の業績は、さまざまなリスク要因や不確実な要素により業績見通しと大きく異なる可能性があり、これらの業績見通しに過度に依存しないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の現象、その他の結果に関わらず、当社が業績見通しを常に見直すとは限りません。実際の業績に影響を与えるリスク要因や不確実な要素には、以下のものが含まれます。(1)当社の事業を取り巻く経済情勢、電子機器及び電子部品の市場動向、需給環境、価格変動、(2)原材料等の価格変動及び供給不足、(3)為替レートの変動、(4)変化の激しい電子部品市場の技術革新に対応できる新製品を安定的に提供し、顧客が満足できる製品やサービスを当社グループが設計、開発し続けていく能力、(5)当社グループが保有する金融資産の時価の変動、(6)各国における法規制、諸制度及び社会情勢などの当社グループの事業運営に係る環境の急激な変化、(7)偶発事象の発生、などです。ただし、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。

当資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。